

通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2



SA ルーティング®
Multi

1 試適後、 サンドブラスト処理※1・ 超音波洗浄・乾燥



2 ボンド塗布



3 乾燥

マイルドなエアアブローで
5秒以上乾燥※2



4 ペースト塗布

オートミックスの場合

又は

ハンドミックスの場合

クラウンまたは窩洞内に
ペースト塗布



操作時間

操作時間 (23℃)	1分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37℃)	30秒

① AペーストBペースト
等量採取・10秒練和



水分混入をさけるため練和紙、
練和棒は冷蔵保管しない

② クラウンまたは
窩洞内にペースト塗布

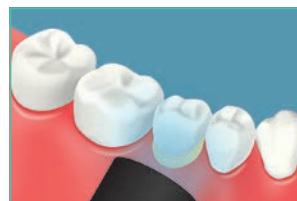


操作時間

操作時間 (23℃)	2分
ペーストを窩洞内に塗布 した場合の操作時間 (37℃)	30秒

5 装着・余剰セメント の除去※3

1か所につき
1～2秒光照射



6 最終硬化 (5分保持)※4



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。サンドブラスト処理後に試適した場合には、リン酸エッチング材等を電子添文等にしたがって処理し(リン酸エッチング材は5秒間処理)、水洗・乾燥を行います。歯科セラミックス用接着材料を電子添文等に従い適用することも可能です。

※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。

※3 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。

※4 光を透過する補綴装置の場合はクラウン全体への光照射(右表参照)による最終硬化も可能です。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.1を参照ください。